

Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

SMD-Leiterplattenklemme Nano mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

2-polig - 46.142.1001.50

Direktes Stecken von eindrätigen Leitern

Kontaktöffnungsfunktion - zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

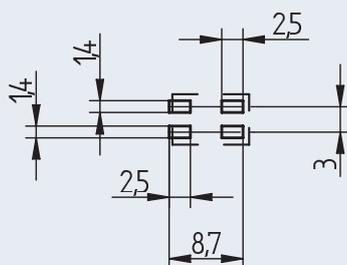
Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 61076-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
 Kontaktwerkstoff: CuNi
 Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unseres Werkzeugs 46.141.U801.89

Empfohlene Maße für die Lötflächen



Daten zur Verpackung 46.142.1001.50	
Gewicht SMD-Klemme	0.4 g
Anzahl pro Spule	4.050
Durchmesser der Spule	381 mm - 15"
Gewicht pro Spule	1.52 kg
Anzahl an Spulen pro Karton	18
Anzahl an SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	72.900
Gewicht pro Karton	23.5 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 415 mm



Zubehör:

SMD Nano-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in 21 mm Länge erhältlich.



46.141.U701.50



46.142.U701.50



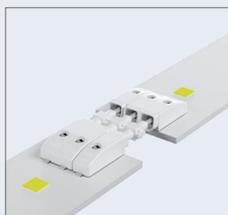
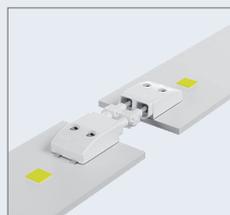
46.143.U701.50

Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter



46.141.U801.89



Anschlussdaten	
Anschluss technik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.2 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Abisolierlänge	7 ± 0.5 mm
Leitereinführung	0
Leiterlösefunktion mittels	Werkzeug zur Kontaktöffnung

Auszugskraft nach DN 60999-1	
0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten	
Rastermaß	3 mm / 0.12 inch
Breite	6 mm / 0.24 inch
Höhe	2.7 mm / 0.11 inch
Tiefe	9.3 mm / 0.37 inch
Spulendurchmesser Gurtverpackung	330 mm (13")
Gurtbreite	16 mm
Pitchabstand	8 mm
Verpackungseinheit Tape-and-Reel	2.800
Verpackungseinheit Karton	50.400 (18 Spulen)

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktwerkstoff	CuNi
Kontaktfläche	feuerverzinkt

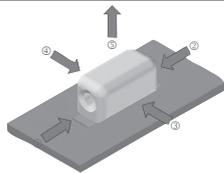
Mechanische Daten	
Montageposition	Leiterplatte oberseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

Temperaturbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-40 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 125 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120° C

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1)	
Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	3 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3	
Bemessungsspannung	320 V
Bemessungsstrom	USR 9 A, AWG 24 -18 CNR 6 A, AWG 24 -20 CNR 9 A, AWG 18

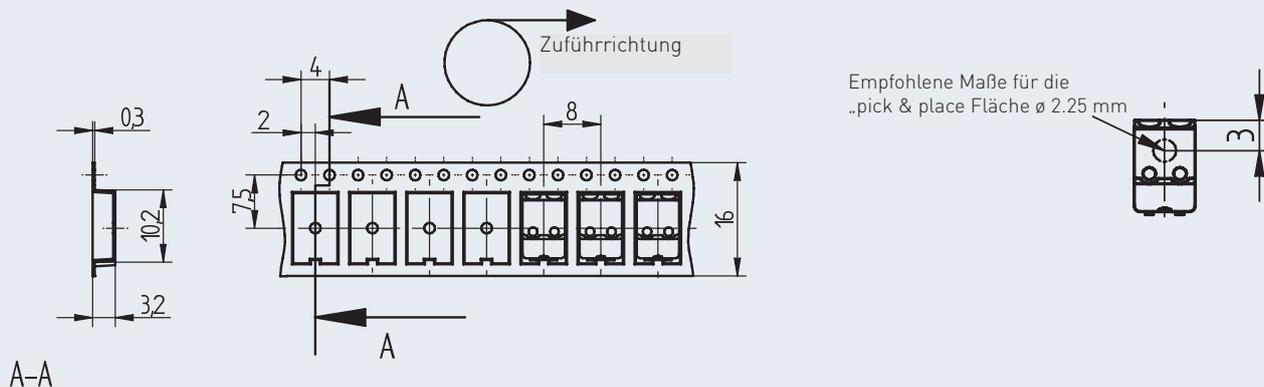
Länderspezifische Zulassungen Zertifikate	
VDE / ENEC	EN IEC60947-7-4 Ausweis-Nr.: 40040866
cURus	UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3, File No. E-365006

Scherkräfte nach IEC 62137-1-2.	
Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.	
Richtung 1 + 2 Scherkraft längs	60 N
Richtung 3 + 4 Scherkraft quer	25 N
Richtung 5 Abzugskraft	25 N

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	<p>Reflow-Profil (bleifreies Löten):</p>
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150 µm)